

タッチパネルディスプレイに求められる粘接着剤と貼合技術

日時 2016年3月25日(金) 13:00~16:30

主催 S&T出版株式会社

会場 高橋ビルディング (東宝土地(株)) 会議室 東京都千代田区神田神保町3-2

受講料 43,200円 Eメール案内会員価格 41,000円 ※資料代を含む

(税込) <1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>

※2名様ご参加は同一社・法人からの同時申込に限ります

※2名様ご参加は2名様分の参加申込が必要で、ご連絡なく2名様のご参加はできません

※3名様以上の参加は、追加1名様あたり10,000円OFFになります

Eメール案内登録(無料)をしていただいた方はEメール案内会員価格を適用いたします。

講師 佐伯 和幸 氏 / (株)FUK 企画・営業部 課長

申込受付は終了しました

当社はこれまでにモバイル製品の「ミニノートプロジェク」量産装置を開発してまいりました。その流れにディスプレイの多様化に伴い拡散しており、大型・曲面・異形に対して貼り合わせるニーズが高まっております。

本講演では、最新の粘・接着剤と貼り合わせ技術を動画も交えながら解説いたします。

講演詳細

1. ディスプレイの多様化

- 1.1 ディスプレイの変遷
- 1.2 薄く・軽く・曲がる・割れないデバイスの登場
- 1.3 ディスプレイの多様化

2. 貼り合せと粘・接着剤

- 2.1 モバイル製品の貼り合せ
- 2.2 どうして貼り合わせるの?
- 2.3 光学粘着剤OCA
- 2.4 光学接着剤OCR
- 2.5 粘・接着剤の比較

3. これまでの貼り合せ

- 3.1 OCAによる貼り合せ
- 3.2 他社の貼り合せプロセス
- 3.3 FUKの貼り合せプロセス
- 3.4 大気BEND方式の特徴
- 3.5 フィルム貼付け装置(1stラミネーション)
- 3.6 ガラス貼り合わせ装置(2ndラミネーション)

4. ディスプレイの多様化に伴うラミネーション技術の進化

- 4.1 モバイル狭額縁対応-貼り合わせプロセス(プレキュアOCR)
- 4.2 大型対応-貼り合わせプロセス(OCA)
- 4.3 車載CID対応-曲面貼付けプロセス(OCA)
- 4.4 FUKが実現するラミネーション技術

セミナー申込用紙

セミナー名: ST160325(タッチパネルディスプレイに求められる粘接着剤と貼合技術)

会社・団体名		TEL	
住所 〒		FAX	
①	氏名	部署・役職	
	E-mail		
②	氏名	部署・役職	
	E-mail		
支払方法		<input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> 当日現金 ※銀行振込の場合は振込予定日を記載ください 月 日	
Eメール案内会員登録(無料)		Eメール案内(無料)に <input type="checkbox"/> 登録する <input type="checkbox"/> 登録済み	
<small>※E-mailアドレスが必須です。 ※右記に✓印をつけてご登録いただくと、この申込からEメール案内会員価格で申込できます。 ※Eメールでセミナー書籍の最新情報をご案内致します。</small>		通信欄	

※上記ご記入の上、**FAX 03-3261-0238**までお申込みください。

■お申込み方法
必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。または当社ホームページからお申し込みください。

■受付完了のご連絡

受付完了後、3営業日以内に請求書、受講券、会場案内図を郵送いたします。※お申込み後7日以上経っても受講券・請求書がお手元に届かない場合は、弊社までご連絡ください。
セミナー申し込み後、受講をキャンセルされる場合は、必ず開催日前日から起算して10日前までにご連絡ください。それ以降のご連絡及び、当日欠席の場合、返金はいたしかねますので、代理の方のご出席をお願いいたします。代理の方も出席できない場合は資料の送付で出席に代えていただきます。受講料未入金のまま当日ご欠席されてもキャンセルにはなりません。全額請求させていただきますので予めご了承ください。

■お支払

銀行振込にてお願いいたします。
受講料のご入金は、開催日までお願いいたします。やむなく開催日以降にご入金の場合は、当日現金でお支払またはお申込みの際に振込予定日をご記入ください。銀行振込の場合、領収証の発行はいたしません。

■個人情報の取り扱い

ご記入の個人情報は、商品の発送、事務連絡、ご案内等に使用いたします。